

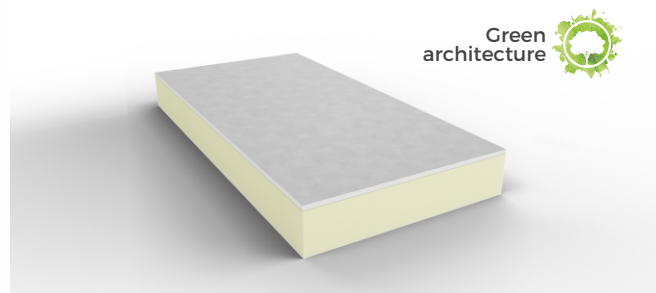
ZALECENIA PRODUCENTA

- Montaż płyt termPIR® WS GK/AL GK do ścian wewnętrznych



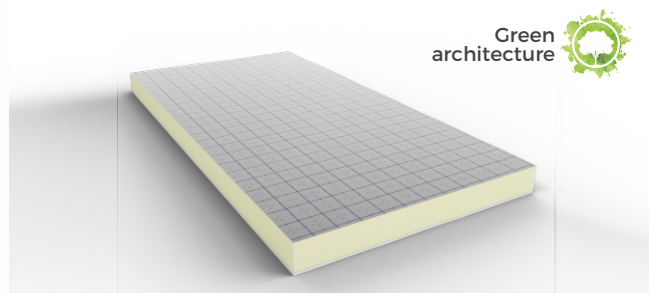
termPIR®
płyty izolacyjne

Wykonanie izolacji termicznej ścian od wewnątrz z płyt izolacyjnych termPIR® WS GK oraz termPIR® AL GK - montaż klejony.



termPIR® WS GK

Green
architecture



termPIR® AL GK

Green
architecture

PARAMETRY WYROBU

Parametry cieplne płyty kompozytowej termPIR® WS GK:

Właściwości		Wartości / Klasy									
Wspł. przewodzenia ciepła, λ_b dla $d_N^* = 20 - 250$ mm		dla ($20 \leq d_N < 80$ mm): 0,026 [W/m·K]			dla ($80 \leq d_N \leq 120$ mm): 0,025 [W/m·K]			dla ($120 \leq d_N \leq 250$ mm): 0,024 [W/m·K]			
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R_D [m ² ·K/W] dla $d_N^* = 20 - 250$ mm :	20	0,75	30	1,15	40	1,55	50	1,90	60	2,30
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R_D [m ² ·K/W] dla $d_N^* = 20 - 250$ mm	70	2,70	80	3,20	90	3,60	100	4,00	110	4,40
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R_D [m ² ·K/W] dla $d_N^* = 20 - 250$ mm	120	5,05	130	5,45	140	5,85	150	6,30	160	6,70
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R_D [m ² ·K/W] dla $d_N^* = 20 - 250$ mm	170	7,15	180	7,55	190	8,00	200	8,40	210	8,80
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R_D [m ² ·K/W] dla $d_N^* = 20 - 250$ mm	220	9,25	230	9,65	240	10,10	250	10,50		

Parametry cieplne płyty kompozytowej termPIR® AL GK:

Właściwości		Wartości / Klasy									
Wspł. przewodzenia ciepła, λ_b dla ($20 - 250$ mm /+ 12,5 mm)		0,022 [W/m·K]									
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R_D [m ² ·K/W] dla $d_N^* = 20 - 250$ mm :	20	0,90	30	1,35	40	1,85	50	2,30	60	2,75
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R_D [m ² ·K/W] dla $d_N^* = 20 - 250$ mm	70	3,25	80	3,70	90	4,15	100	4,65	110	5,10
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R_D [m ² ·K/W] dla $d_N^* = 20 - 250$ mm	120	5,55	130	6,05	140	6,50	150	6,95	160	7,45
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R_D [m ² ·K/W] dla $d_N^* = 20 - 250$ mm	170	7,90	180	8,35	190	8,85	200	9,30	210	9,75
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	Opór cieplny: R_D [m ² ·K/W] dla $d_N^* = 20 - 250$ mm	220	10,20	230	10,70	240	11,10	250	11,60		

* Podana wartość grubości odnosi się do grubości rdzenia PIR, a nie grubości płyty kompozytowej

Parametry ogniowe:

Reakcja na ogień (w zastosowaniu końcowym)

Klasa **B-s1,d0**

(dla grubości $d_N = 20-140$ mm /12,5mm);

NPD (dla grubości $d_N = 141-250$ /12,5 mm)

ZALECENIA PRODUCENTA

- Montaż płyt termPIR® WS GK/AL GK do ścian wewnętrznych



termPIR®
płyty izolacyjne

Wymiary płyt (długość/szerokość): **2600 x 1200 mm**. Na zamówienie dostępne są również inne długości płyt.

Szczegółowe informacje zawarte są w **Deklaracji Właściwości Użytkowych** oraz **Karcie Technicznej**.

Płyty kompozytowe PIR z karton-gipsem wytwarzane są poprzez połączenie płyty **termPIR® WS** lub **termPIR® AL** (produkcji Górz-Stal) oraz płyty karton-gips za pomocą kleju kontaktowego.

Parametry płyty termPIR® WS GK, AL GK

Gęstość rdzenia termPIR® 30 kg/m³

Parametry płyty karton-gips (na podstawie deklaracji producenta)

Reakcja na ogień Klasa **A2-s1,d0**

Przewodność cieplna (dla grubości 12,5 mm) **0,25 [W/m·K]**

▷ ZALECENIA DLA SYSTEMU KLEJONEGO

- Płyty **termPIR® GK** można przyklejać bezpośrednio do ścian z pustaków lub cegieł ceramicznych, betonowych, bloczków z betonu komórkowego itd.
- Silnie chłonna podłoga należy zwilżyć/zagruntować przed przyklejeniem płyt **termPIR® GK**. Ściany wykończone tynkiem cementowym i gipsowym należy sprawdzić pod względem przyczepności.

Zdolność do przylegania do malowanych lub zawilgoconych powierzchni zależy od stanu lub rodzaju użytego kleju.

- Przed przystąpieniem do przyklejania płyt **termPIR® GK** do ściany należy usunąć wszelkie nierówności jak; luźny tynk, pozostałości tapety, kurz, tłuź, sadzę itd.
- Podłogę należy zwilżyć/zagruntować przynajmniej 15 min. przed klejeniem
- Płyty **termPIR® GK** należy dodatkowo przymocować mechanicznie za pomocą odpowiednich wkrętów (np. kołek rozporowy do szybkiego montażu uderzeniowego do płyt g-k, stalowy, ocynkowany z koszulką tworzywową). Kołki należy dobrać do odpowiedniej długości w zależności od grubości warstwy PIR oraz w zależności od podłoża. Ilość kołków 5-6 szt/m² (montować co ok. 50 cm, 15-20 mm od krawędzi płyty, główka trzpienia mocowana nieco głębiej, aby możliwe było zakrycie jej przy wykańczaniu). Należy uważać aby w trakcie kołkowania nie uszkodzić płyty.
- Klej musi być dobrany do rodzaju podłoża oraz rodzaju okładziny płyty **termPIR®**. Przed montażem wykonać próbę przyczepności kleju do podłoża i do płyty.
 - Do płyt z okładziną z welony szklanego (**WS GK**) odpowiedni będzie klej przeznaczony do klejenia styropianu lub klej poliuretanowy, aplikowany np. za pomocą pistoletu, a do płyt z okładziną aluminiową (**AL GK**) - klej poliuretanowy.
- Płyty **termPIR® GK 2600x1200 mm** przykleja się do podłoża poprzez naniesienie na płytę zaprawy klejowej w postaci min. 14 placków o średnicy min 15 cm i pasma obwodowego o szer. min 10 cm przy krawędziach.

Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. Dokładna ilość masy klejącej zależy od stanu podłoża i musi być tak dobrana, aby zapewnić wymagana przyczepność.

- Płyty nie mogą stykać się z podłogą (zalecana jest szczelina ok. 1 cm lub zabezpieczenie od przeciągania wilgoci).

Szczelinę pomiędzy płytami g-k należy zafugować, wykończyć szpachlą i zabezpieczyć siatką (identycznie jak połączenia płyt gipsowo-kartonowych). Szczeliny należy wykończyć szpachlą dobraną do wymaganego w danym pomieszczeniu poziomu zabezpieczenia ogniowego.

Warstwa PIR powinna przylegać do siebie. Jeżeli zdarzy się szpara należy ją wypełnić pianą montażową niskoprężną. Nie dopuszczalne jest wypełnienie ewentualnych szczelin masą gipsową.

- Najlepiej montować płyty w temperaturach pomiędzy 5 - 20 °C.
- Dalsza obróbka jest identyczna jak obróbka płyt gipsowo-kartonowych.